

2009年3月期 第2四半期決算説明会

株式会社ディスコ

2008年11月13日
ベルサール八重洲

将来の見通しに関する注意事項

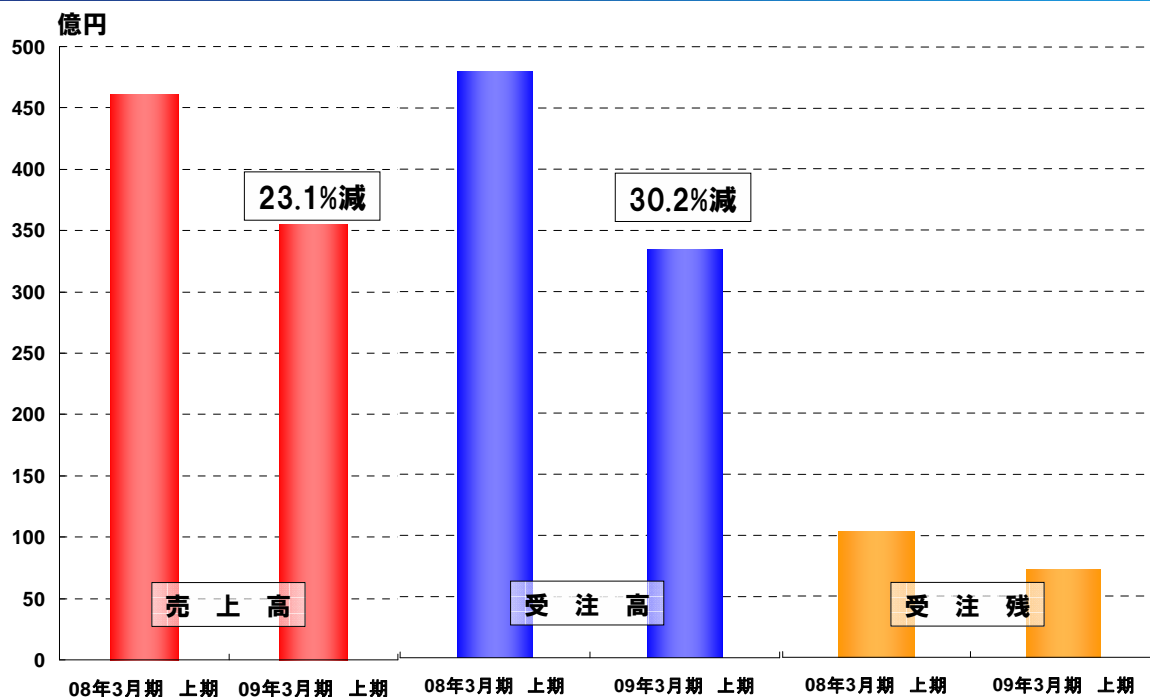
このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的
事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得ら
れた当社の経営者の判断に基づいております。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりう
ることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変
動ならびに戦争・テロ活動等があります。

2009年3月期第2四半期決算概要

常務取締役 IR・広報室長
関家圭三

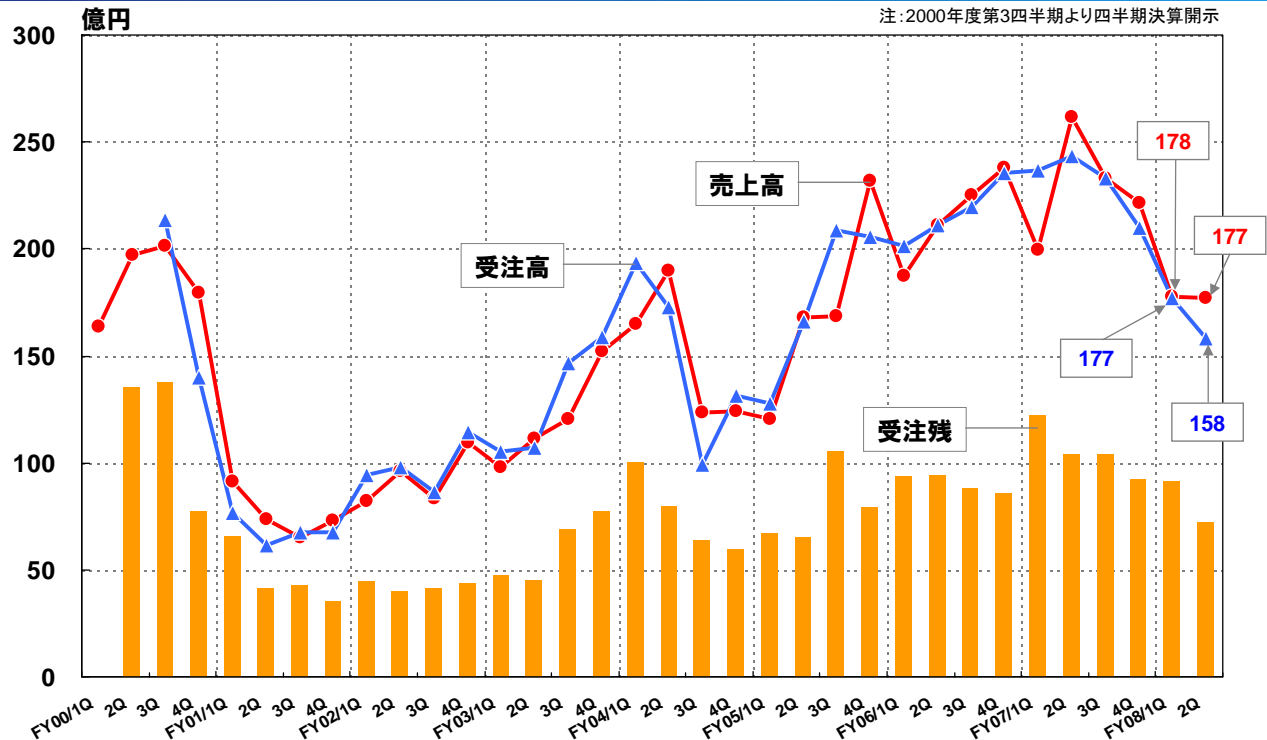


- 半導体市況の長期低迷および景気の減速から、顧客企業の投資抑制により売上高・受注高ともに減少（前年同期比で売上高23.1%減、受注高30.2%減と非常に厳しい状況）

●第2四半期累計期間における半導体メーカーの投資抑制が非常に大きく影響し売上高、受注高共に大幅に減少しました

売上高は355億円（前年同期比23.1%減）、受注高は335億円（前年同期比30.2%減）、受注残は72億円となりました

連結売上高・受注高 四半期推移

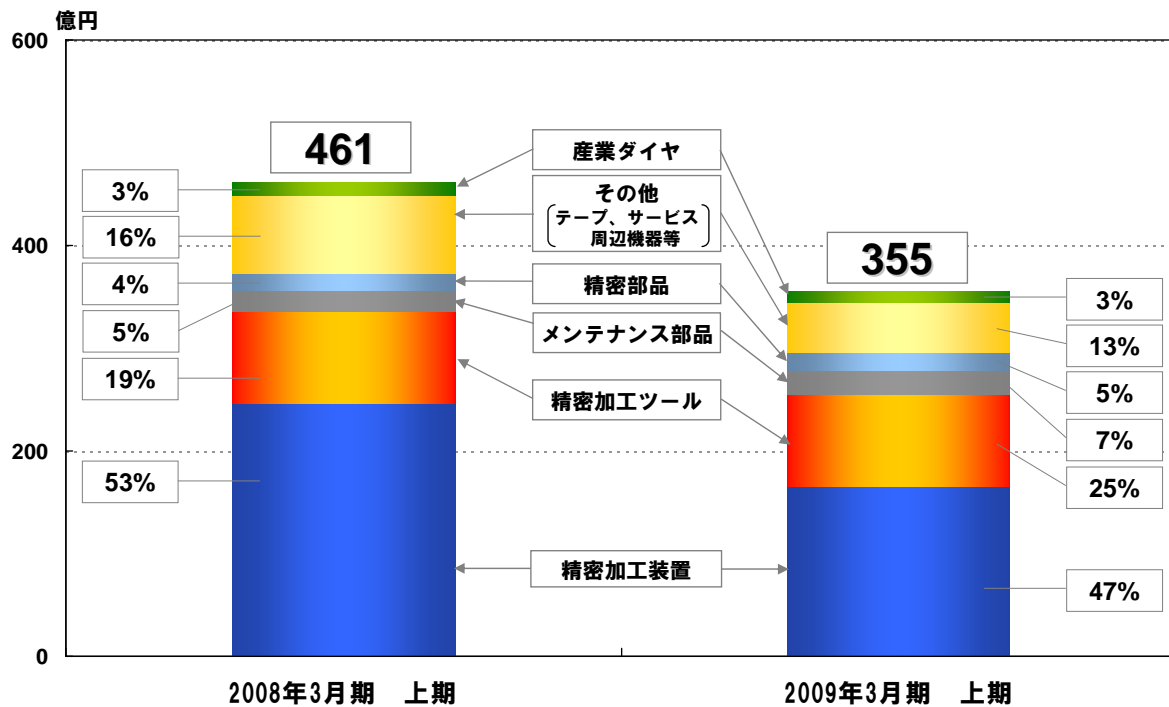


- 前期からの落ち込みが大きかったものの、第2四半期の売上高は第1四半期の水準を維持
- しかし受注高については引き続き下落基調で推移

●四半期推移では第1四半期から第2四半期にかけての売上高はほぼ横ばいで推移しましたが、受注高は第1四半期に引き続き下落傾向にあります

●当社の場合、売上高と受注高はほぼ同額で推移する傾向にありますが、市場の急激な変動が起きた時、このような現象が起こる場合があります

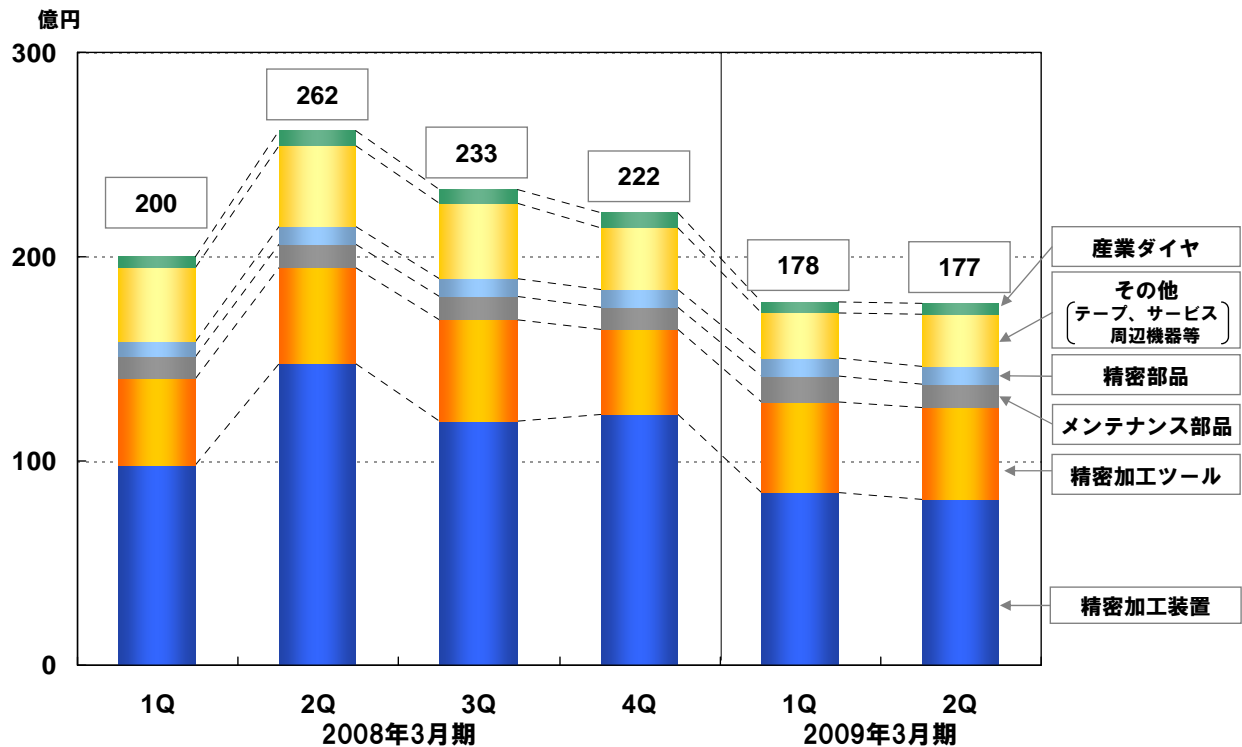
連結売上高 製品群別構成 上期比較



- 精密加工装置の売上高が大きく減少した結果、他製品の売上高構成比が上昇
- 特に精密加工ツールは高水準を維持しており、構成比でも25%を占める

- 精密加工装置は売上高が大きく落ち込んだ為、構成比においても50%を切りました
- 精密加工ツールは売上高が微増した為、構成比で25%を占める結果となりました

連結売上高 製品群別構成 四半期推移



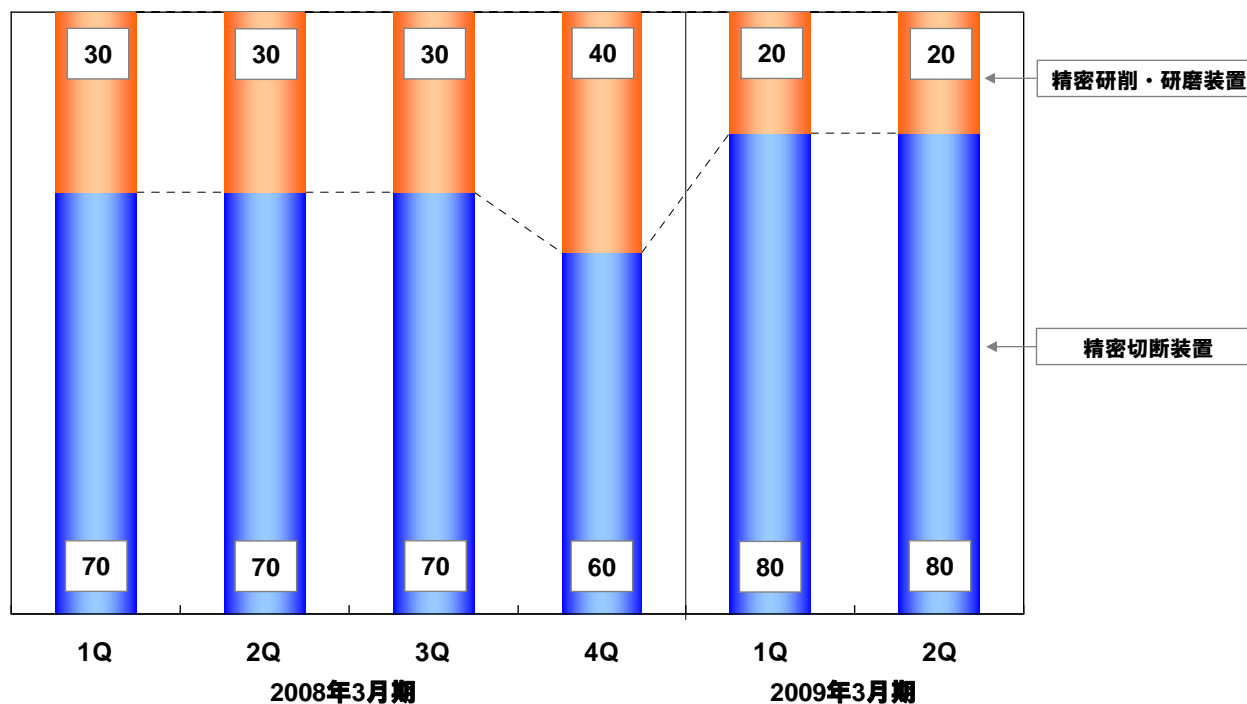
- 前期末からの精密加工装置の落ち込みが大きかったものの第1～2四半期にかけては横ばいで推移
- 精密加工ツールは第1、第2四半期で微増となり数量ベースでは増加が継続

●売上高の四半期推移をみますと前期第4四半期からの落ち込みが大きかったものの、今期の第1四半期から第2四半期にかけては精密加工装置はほぼ横ばいで推移しました

●精密加工ツールにつきましては第1四半期から第2四半期にかけて微増となりました

精密加工装置 構成比概数 四半期推移

(%)

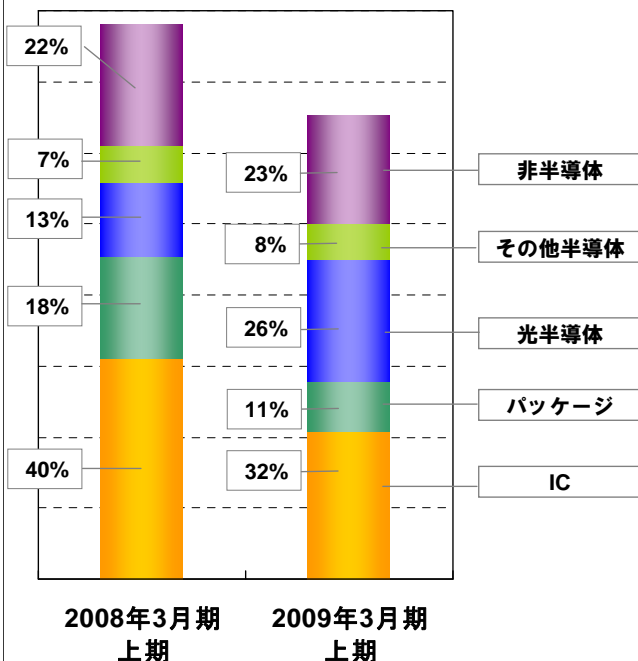


- 精密加工装置の構成比は「精密研削・研磨装置」の売上高減少が響き「精密切断装置」の割合が高まる

●こちらは精密加工装置を、「精密切断装置」と「精密研削・研磨装置」に分類したグラフです
これまで「精密切断装置」7、「精密研削・研磨装置」3程度の割合で推移していましたが、「精密研削装置」の売上減少が大きく、「精密切断装置」の割合が高まっています

精密切断装置* 売上構成 (アプリケーション別・単体)

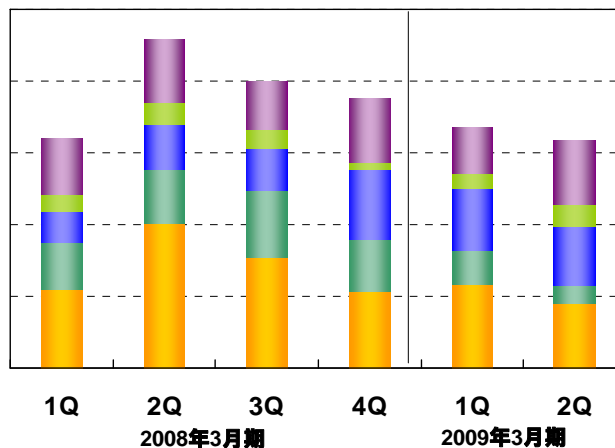
上期比較



注：精密加工装置

ダイシングソー、レーザー、他

四半期推移

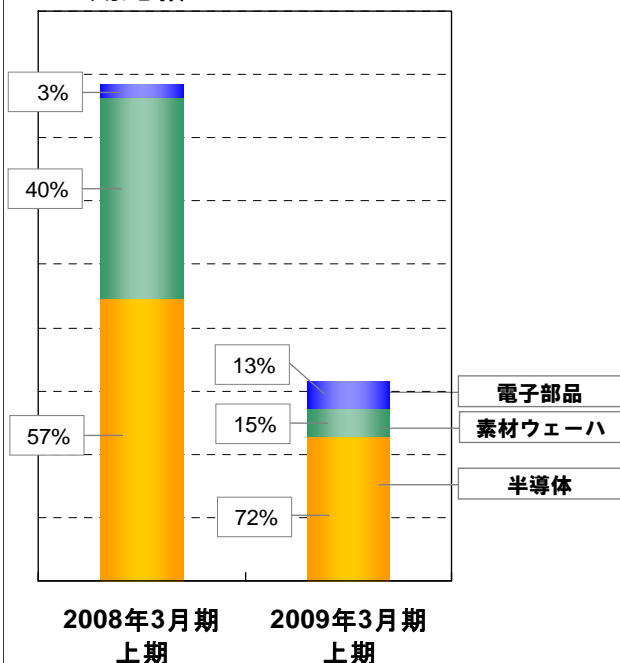


- メモリをはじめとしてIC関連の設備投資が停滞しており、ICおよびパッケージ向けの売上が大幅に減少
- LED切断用のレーザーの出荷が好調に推移し、光半導体の占める割合が高まった
台湾を中心にLED向けレーザが好調

●精密切断装置はメモリをはじめとしてIC関連の設備投資が停滞しており、IC、パッケージが前年同期と比べ大幅に下落しています

●一方、LED切断用のレーザーは既に今上期において前年度1年分台数を売り上げており好調に推移したことで光半導体が伸びました

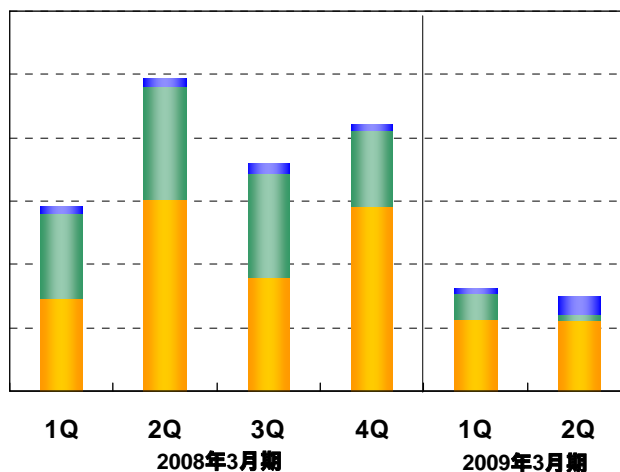
上期比較



注：精密研削・研磨装置

グラインダ、ポリシャ、グラインダポリシャなど

四半期推移



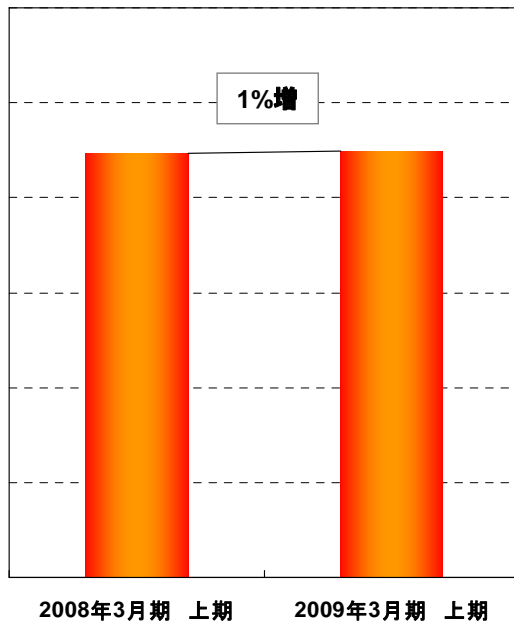
- 素材ウェーハ用グラインダの投資が一巡し、大幅に減少
- 薄化装置の牽引役であるメモリメーカーの投資再開の目処が立たず売上が低迷

●精密研削・研磨装置は非常に大きく減少しました

特に素材ウェーハ向けは、昨年度で投資が一巡したと言われたとおり大きく減少しました

半導体向けも薄化を牽引してきたメモリメーカーが投資を抑制されており、再開の目処が立っていない状況と見られ大きく落ち込んでいます

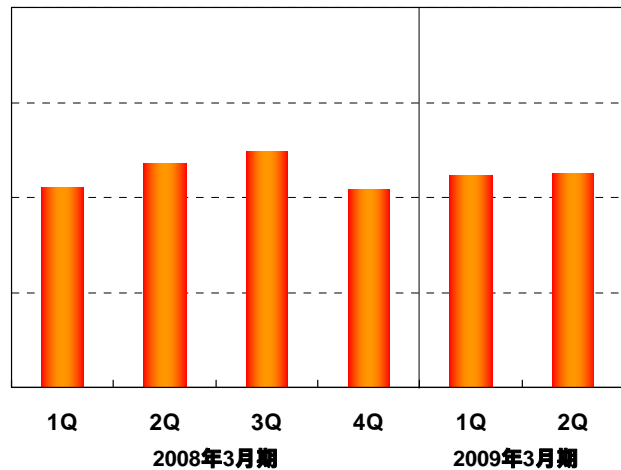
上期比較



注：精密加工ツール

ダイシングブレード、グラインディングホイール、
ドライポリッシングパッド他

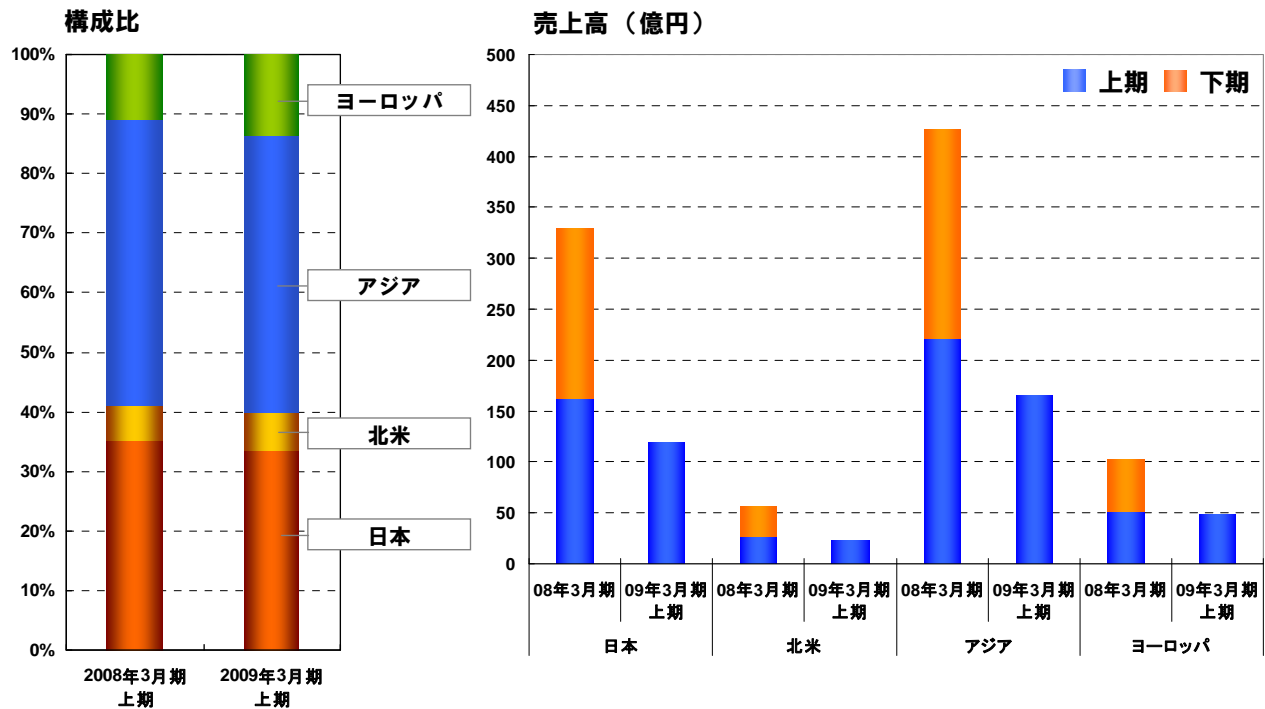
四半期推移



- 半導体メーカーの設備投資意欲が減退する中でも消耗品である精密加工ツールは安定して推移
- 為替の影響で金額的な伸びは小さいものの、出荷数量では堅調に増加

●精密加工ツールの売上高は前年同期と比較して微増の1%増となりました
四半期推移でも昨年度の第4四半期から比較しますと微増傾向にあります

地域別売上高 上期比較



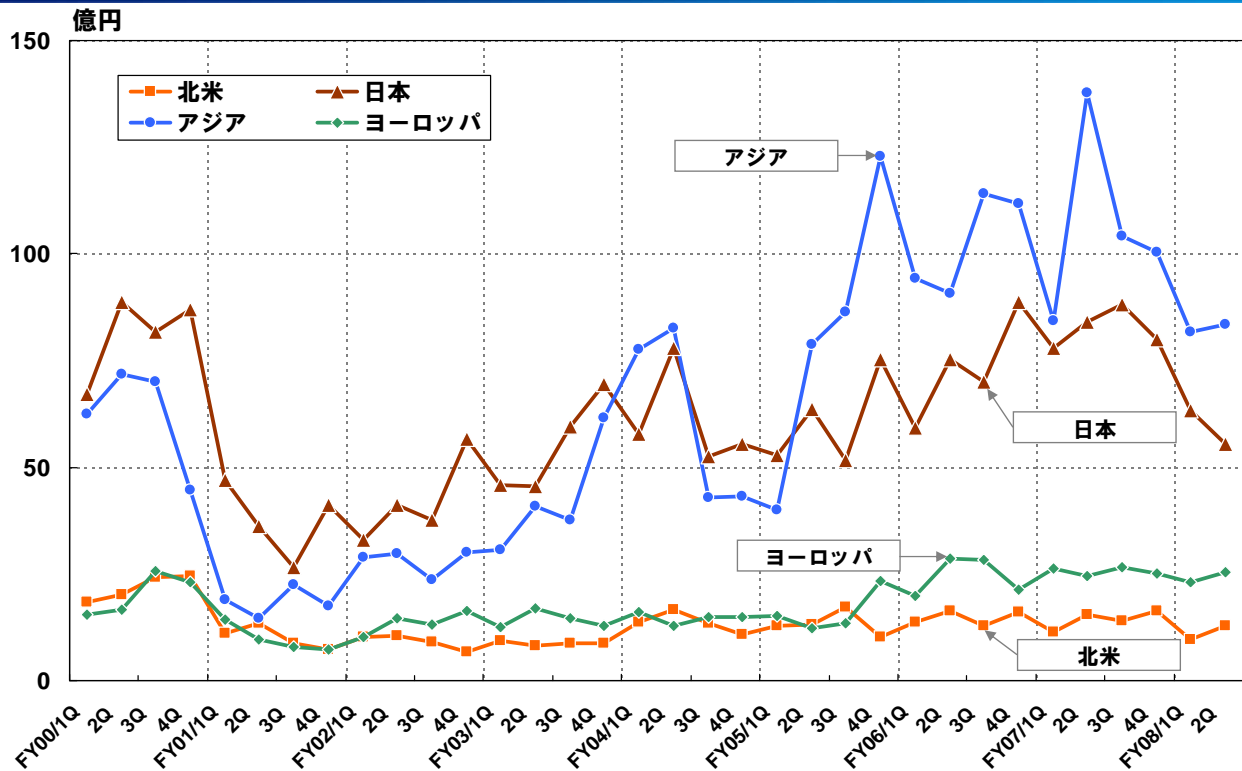
- 構成比は日本、アジアの売上高が減少していることによりヨーロッパの割合が高まる
- 売上高は前上期と比較すると日本、アジアにおいてはそれぞれ約25%減少と厳しい状況

●地域別売上高では日本、アジアにおける売上高が前年同期と比べてそれぞれ約25%も減少し大きく落ち込みました

しかし北米、ヨーロッパにおける売上高は若干の減少でした

●その結果、構成比は日本、アジアの割合が大きく減少し、北米、ヨーロッパの割合が高まりました

地域別売上高 四半期推移



● 四半期推移ではアジア、北米、ヨーロッパが第2四半期で微増に転じたが、日本での販売は厳しい

●地域別売上高を四半期推移で見ますと日本以外の売上高は第1四半期から第2四半期にかけては増加に転じていますが、日本の売上高のみマイナスとなっています

2009年3月期第2四半期決算概要

(単位: 億円 四捨五入)	2008年3月期 上期	2009年3月期 上期	上期比較差異		2009年3月期 上期 (8/8予想)	予想比較差異	
			金額	(%)		金額	増減 (%)
売上高	461	355	△106	△23.1	375	△20	△5.4
売上総利益	238	175	△63	△26.5	-	-	-
GP率	51.6%	49.3%	-	-	-	-	-
販売管理費	128	135	8	6.1	-	-	-
営業利益	110	39	△71	△64.2	45	△6	△12.2
経常利益	110	41	△70	△63.1	46	△5	△11.6
経常利益率	23.9%	11.5%	-	-	-	-	-
税前利益	110	37	△74	△66.6	-	-	-
当期純利益	62	27	△35	△57.1	23	4	15.6
一株あたり利益(円)	182.51	78.36	△104.15	△57.1	67.7		
減価償却費	15	20	4	27.2	-	-	-
設備投資費	39	69	30	76.4	-	-	-
研究開発費	35	41	6	17.1	-	-	-

- 売上高の減少および為替の影響などにより、昨年度より若干GP率が悪化
- 将来のための先行的な人員拡充および研究開発投資により、販売管理費が増加
- 法人税等負担率が見込みより軽減したことにより当期純利益は予想より増加

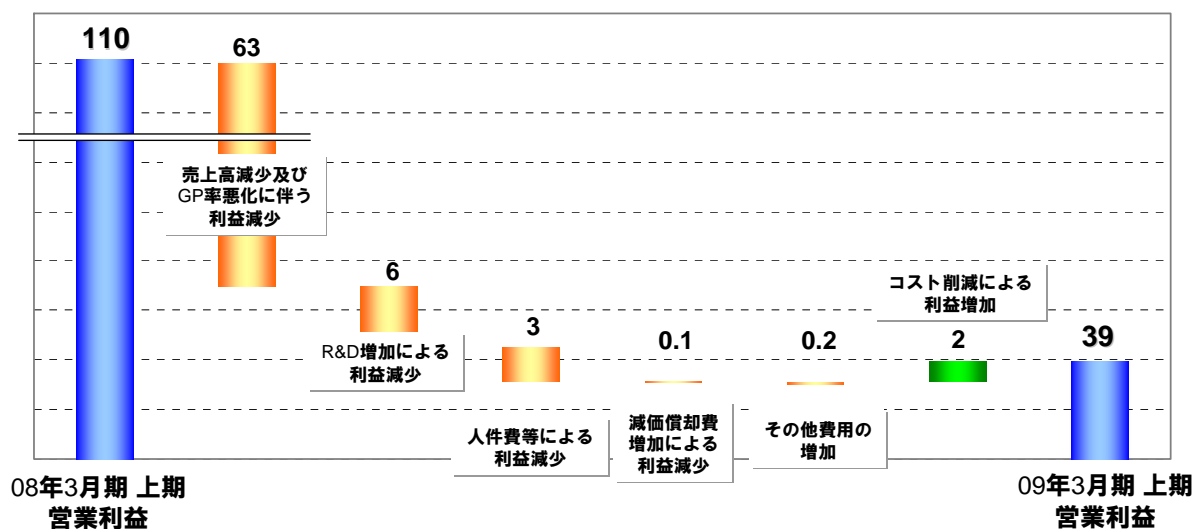
●このような売上状況のもと、損益につきましては売上減少と為替の影響により前年同期と比較してGP率が2.3%悪化しました

●販売管理費については戦略的な人員拡充や研究開発投資を行っており8億円弱増加しています

●税金については外国税額の控除や研究開発費の控除が増えた為、法人税の負担が減少したことにより8月の予想発表時からプラス4億円となりました

●この結果、営業利益は39億円（前年同期比64.2%減）、経常利益は41億円（前年同期比63.1%減）、当期純利益は27億円（前年同期比57.1%減）となりました

(単位：億円)



- 為替の影響による売上高の減少 約9.5億円
 08年3月期上期 実効レート US\$ 119.20円 → 09年3月期上期 106.23円
- 先行的な研究開発への取り組み
 08年3月期上期 35.2億円 → 09年3月期上期 41.3億円

●営業利益の減少要因ですが前年同期の営業利益が110億であったのに対し、売上高減少及びGP率悪化により63億円の減少（内為替の影響9.5億円）、研究開発費の増加により6億円減少、人員増により3億円減少などがありましたが、販管費のコスト削減による2億円増加の結果、2009年3月期上期の営業利益は39億円になりました

バランスシート(抜粋)

(単位: 億円 四捨五入)	2008年3月期	2009年3月期		増減
	期末 (08年3月31日)	1Q 期末 (08年6月30日)	2Q 期末 (08年9月30日)	2008年3月期末 2009年3月期2Q比較
流動資産	699	614	557	△141
現預金	191	143	126	△64
受取手形・売掛金	271	241	204	△67
たな卸資産	199	198	192	△7
その他	38	27	34	△3
固定資産	487	489	531	43
有形・無形固定資産	421	423	462	41
投資その他の資産	66	62	68	2
資産合計	1,186	1,103	1,088	△98
流動負債	264	180	159	△104
固定負債等	26	25	24	△2
純資産合計	897	898	905	9
自己資本比率 (%)	75.0%	80.7%	82.7%	-
負債純資産合計	1,186	1,103	1,088	△98

- 現預金は仕入債務支払や有形固定資産取得代金支払、配当金支払等により前期末比64億円減少
- 支払手形及び買掛金等が減少したことにより流動負債が104億円減少、自己資本比率は82.7%に上昇

●流動資産では売上債権の回収が進み、受取手形・売掛金が67億円減少しました

また現預金では仕入債務支払や有形固定資産取得の支払、配当金支払、法人税支払等があり64億円減少しました

●流動負債では仕入債務の減少等により104億円減少しました

●この結果、第2四半期末時点の自己資本比率は82.7%に上昇しました

キャッシュフロー(抜粋)

(単位: 億円 四捨五入)	2008年3月期 上期	2009年3月期 上期	(ご参考) 2008年3月期 通期
営業キャッシュフロー	33	33	93
税前純利益	110	37	185
減価償却費	15	20	37
売上債権・たな卸資産・仕入れ債務	△31	9	△35
法人税等の支払額	△50	△19	△89
その他	△12	△15	△5
投資キャッシュフロー	△61	△86	△118
有形固定資産の取得による支出	△31	△80	△94
定期性預金の預入による支出・収入他	△30	△6	△24
財務キャッシュフロー	△19	△15	△32
有利子負債の減少	△3	-	△2
親会社による配当金の支払額	△15	△15	△27
その他	△1	△0	△3
フリーキャッシュフロー	△27	△54	△25
現金および現金同等物の増加額	△46	△64	△60
現金および現金同等物の期末残高	195	116	181

- ・ 売上高の減少が響き税前純利益が低調であったものの、売上債権減少による資金増加等により営業CFは33億円の資金増加
- ・ 異工場新棟の支払代金等、有形固定資産の取得による支出により投資CFは86億円の資金減少

- 営業フリーキャッシュフローは、税前純利益が低調でしたが売上債権・たな卸資産・仕入れ債務が減少したこと等により前年同期と同等の33億円の資金増加となりました
- 投資フリーキャッシュフローは、工場新棟等の有形固定資産の取得代金の支払いで86億円の支出となりました
- 財務フリーキャッシュフローは、主に配当金の支払いにより15億円の支出となりました
- この結果、フリーキャッシュフローは54億円の支出となりました

2009年3月期通期 連結業績見通し

(単位: 億円 四捨五入)

	2009年3月期					2008年3月期	
	1Q 実績	2Q 実績	上期 実績	下期見通し (今回)	通期見通し (今回)	通期実績	通期 対前年比較
売上高	178	177	355	300	655	916	△261
営業利益	19	21	40	9	48	193	△145
経常利益	19	21	41	16	57	186	△129
経常利益率	10.8%	12.1%	11.5%	5.4%	8.7%	20.3%	△11.6pt
当期純利益	13	14	27	7	32	111	△79
減価償却費			20	27	47	37	10
設備投資			69	83	152	100	52
研究開発費			41	52	93	83	10

- 下期想定為替レート： US\$/95円 Euro/120円 SGP\$/70円
- 為替1円あたり影響額（半期）： US\$ 73.7百万円 Euro 6.8百万円
- 想定実効税率： 40%
- 精密加工装置は、対前年比40%以上の落ち込みを見込む
 - レーザは前年比倍増を計画
 - グラインダは60%近くダウン
- 精密加工ツールは、為替等の影響もあり前年度並みもしくは若干の減少を想定

●厳しい市場環境の中、今回業績予想を修正しました

売上高655億円、営業利益48億円、経常利益57億円、当期純利益32億円と予想しています

●想定為替レートはUS\$/95円 Euro/120円 SGP\$/70円を前提とし、想定実効税率は40%を見込んでいます

●減価償却費については47億円を見込んでいます

●設備投資については前回予想発表時から10億円増加の152億円を見込んでいます

これはお客様に貸し出す評価貸出機分の増加分で、今のような生産の忙しくない時期において当社製品をお客様に評価していただき、次の導入につながることを目的としています

●研究開発費は前回発表の93億円を据え置いています

これは研究開発の優先順位を大きく見直しましたが、まだ研究すべき課題が多い為です

	中間期	期末	年間
2008年3月期(実績)	35円	44円	79円
2009年3月期(予想)	10円	10円	20円

今期 配当性向20%適用した場合 → 1株当たり配当額19円

このため安定配当額 年間20円を適用 (予想配当性向 21.2%)

【配当方針】

1. 連結業績に連動した配当（配当性向20%）
2. 安定配当として最低20円の配当金を維持。ただし3期連続で連結純損失の場合を除く
3. 4年累計連結売上高経常利益率が20%を達成した場合、通常20%である配当性向を24%とする
4. 赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額(*)を超過した場合は、上記1.に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乘せする

【注】2008年3月期末時点予定必要資金額 300億円

●配当につきましては業績予想を修正した結果、4年累計経常利益率が20%を下回ることとなります
 しかし配当性向20%を適用した場合、1株当たり配当金が19円となるため、安定配当額である年間1株当たり配当額20円を適用することとなりました

●このため中間配当10円、期末配当10円、年間で20円の配当を予定しております

事業環境と経営方針

代表取締役社長
溝呂木 齊

●2008年上期

- 事業環境は厳しさを増してきた
- メモリ(DRAM/NAND)、パッケージシンギュレーション、ウェーハメイキング向け等は、投資意欲減退で過去数年牽引してきたアプリケーションが失速
- 消耗品事業は比較的堅調に推移
- レーザ事業の順調な立ち上がり
 - ・ LED向けレーザソー(台湾向け等)

—上期の状況から見通しを修正した—

●まず当社を取り巻く事業環境についてお話しします

2008年上期につきましては、当社の主力アプリケーションであるメモリ（DRAM）、パッケージシンギュレーション、ウェーハメイキング向けなどは大きく減少しました

●消耗品である精密加工ツールはお客様の稼働率が維持されていたので比較的堅調に推移しました

●レーザ事業も比較的順調に推移していたこともあり、台湾へLED向けのレーザソーが出荷されました
また米国のファブレス企業が台湾サブコンに注文を出していた為、ロジックIC・FPD用ICやMEMS向けドライカット等での需要があったことから順調に推移しました

●2008年下期の見通し

- 世界同時不況/従来のシリコンサイクルともITバブル崩壊とも違う『底の見えない危機感』
- 今迄は落ちているときに登り坂が見えた
- 当面は最終商品の需要増（牽引する商品・地域）も期待できない
- 顧客の先行き不安・見通しつくまで様子見。不安感
- 半導体業界における設備過剰、価格下落、資金調達不安

当面の間、半導体・電子部品業界の設備投資抑制が続く→厳しい事業環境

—業績予想の下方修正をする—

●下期の見通しですが、現在の状況は従来のシリコンサイクルやITバブルの時とは危機の性質が違うものであると認識しており、今回のように経済全体が落ち込んでいる場合「底が見えない」危機感を抱いています

●最終商品（電子機器）の需要増加が期待できずさらに厳しい環境を想定しています

パソコン、携帯電話等の需要落ち込みについては、新興国市場（BRICS等）の伸びがそれをカバーできる程の力は無いと考えています

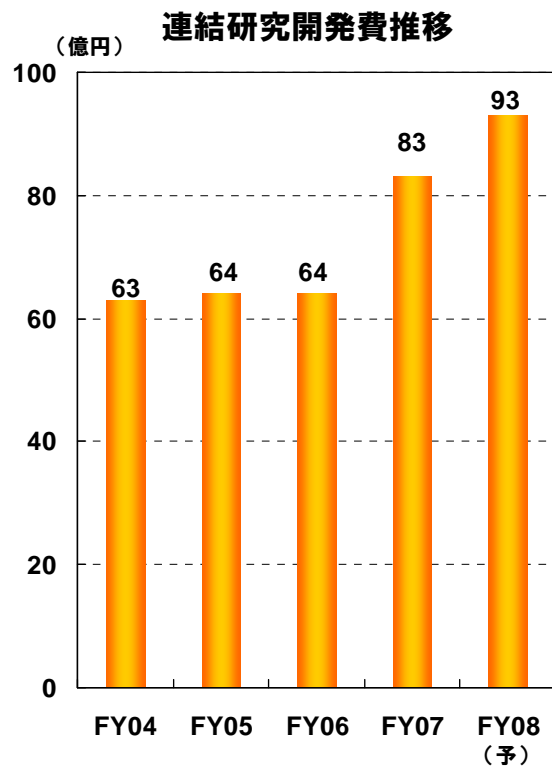
それ故に当社のお客様であるメーカーでは非常に先行きへの不安、様子見ムードが強まっており設備投資の萎縮心理が働いていると市場から感じています

●半導体業界においては設備が過剰となっており、DRAMの設備過剰と競争激化によって価格が下落しており設備投資するような状況ではなく、一部では資金調達への不安も感じています

●競争力のある商品を作っているサブコンやIDM、あるいはファブレスメーカーからの需要はありますが全体の落ち込みをカバーできるものではありません

●当面は半導体・電子部品業界の設備投資抑制が続くものと思われます

次の成長に向けた布石①



● 厳しい状況であっても、研究開発投資は続ける

- 3次元パッケージ(3 DI)
 - 薄研削-洗浄
 - レーザ切断
 - DAF切断
 - DBG
 - TSV
- レーザ切断
 - LED
 - Low-k
- TAIKOプロセス
 - IGBT(車用パワーデバイス)
- ……
- ……

● 厳しい環境の中でも研究開発投資を続けていきます

当社のビジネステーマであるKiru・Kezuru・Migaku技術の研究開発はこれからマーケットの拡大が期待できる分野へ注力していきます

<3次元パッケージ>

例えば薄化について、3次元パッケージではいくつかのプロセスがありますが、特に「薄研削→洗浄」の研究開発をさらに進めていかなければならないと考えております

それ以外にも、DAF切断（樹脂を切断する技術）、DBG（従来の「研削→切断」から「切断→研削」にプロセスを逆転させた優位性の高い技術）、TSV（貫通電極の技術アプリケーションとしてCMOSイメージセンサ等）、これらは優位性があり先に手がける為にも、一連のプロセスにおいて必要となるKiru・Kezuru・Migaku技術の研究開発に力を入れてまいります

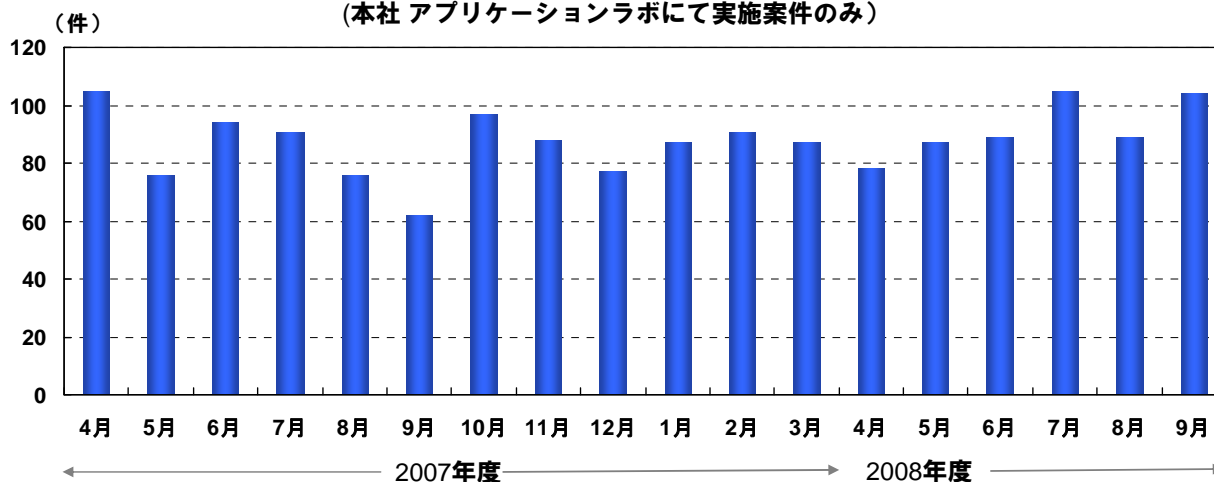
レーザ切断についてはLED、Low-k等、次に向けたアプリケーション開発をしてまいります

当社独自のTAIKOプロセス（ウェーハの淵を残し研削する技術）は、車載用パワーデバイス等に使用されるものであり、現在お客様と研究開発を進めています

その為、07年からは人員の採用を増やして研究開発を進めております

テストカット件数推移

(本社 アプリケーションラボにて実施案件のみ)



- 受注・売上は低調であっても、次の可能性が見える
 - テストカット件数は高水準で推移
 - メンテナンスサービス
 - 顧客の生産性向上
 - 品質向上
 - 稼働率向上

●研究開発に注力していると同時に、市場環境が厳しい中でもお客様からのアプリケーションの依頼があります（3次元、レーザ、薄化、TSVなど）

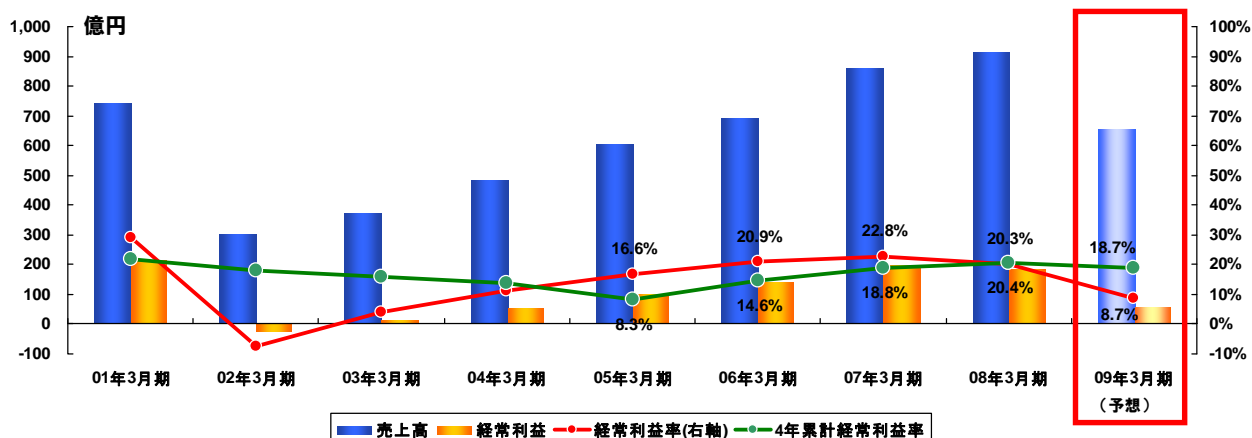
●グラフは本社アプリケーションラボにて実施している件数ですが、2008年度においても高い推移を示しています

このようにアプリケーション部門がお客様とダイレクトにつながっており、研究開発投資が生きて来ていることがわかります

●またメンテナンスサービス部門も活発化しています

これはお客様が設備投資ができない中で、現在保有している機械を最大限に活かした稼働率向上、品質向上のニーズに対応しています

このようにお客様が苦しい状況でも期待に応えられるようにCSを向上させ差別を図っています



1. 年度方針の徹底
2. Kiru・Kezuru・Migaku分野への投資は続ける
効率向上のための投資も継続
3. コスト削減の徹底
 - 年度方針として、毎年5%の構造的経費削減を継続
 - 下期予算で経費の絞り込みや開発テーマの優先順位づけ・効率化
 - 経費レベル”F”を宣言

- 2010年のビジョンに向けて2008年度方針の徹底を図っています
- Kiru・Kezuru・Migaku分野は、当社のコアでありますので投資を続けてまいります
また効率向上の為の投資も行っていきます
(例えば砥石製造や機械組立のコスト低減につながる設備の購入等)
- コスト削減の徹底については4年前から行っており、毎年5%の構造的経費削減を継続してまいります
下期の予算についても経費の絞り込み、研究開発の絞り込み、優先順位付けを行っており効率化に努めています
- 経費レベルについては社内において予想経常利益率に基づきA～Fの6段階に分けており、レベル毎に経費規定が定められています
「F」については「先が見えない市場状況」という設定であり、全ての業務、経費を見直しており効率化を図っています
- 2001年のITバブルはお客様である半導体メーカ、装置メーカ共に非常に大きな在庫を抱えていましたが、ここ6～7年の間で工場能力が格段に向上しており、健全に推移しています

世界的な金融危機に端を発した景気後退は、最終市場の需要減として半導体業界・電子部品業界も大きな影響を与えている。

このような不透明な環境の中で、

- コスト削減の徹底
 - 業務プロセスの効率化

 - 現在と景気回復時に必要な研究開発テーマの推進
 - 企業理念であるDISCO VALUESの浸透活動の継続
- 「喫緊の課題」と「将来のテーマ」に全力で取り組む

●世界的な金融危機に端を発した景気後退は、最終市場の需要減はパソコン、携帯電話、電子機器などが売れないという状況になってきていると考えられます

●また、売れたとしても半導体搭載量の少ない電子機器が売れていると思われます
このように最終需要が低迷しており、半導体・電子部品市場に大きな影響を与えております

●この不透明な市場の中、コスト削減の徹底、業務プロセスの効率化（組織が常に効率的である為の進化）を進めると共に、現在と景気回復時に必要な研究開発テーマを進めていきます

●そして当社の企業理念である「DISCO VALUES」を、効率化を図りつつも浸透させてまいります

DISCO
Kiru・Kezuru・Migaku Technologies



DISCO CORPORATION

●ご清聴ありがとうございました